



WEISS Spindeltechnologie GmbH – A Siemens Company

# *SPAN IN SPINDEL ERKENNUNG*

Stand: 7.08.2019

Autor: Jürgen Müller

# PLANKO VON OTT JAKOB VS. SIS VON PRO MICRON

## Hochgenaue Messergebnisse

Detektion eines Luftspaltes an der Plananlage von min. 10  $\mu\text{m}$

### Planko from Ott

#### **Kurze Messzeit**

ca. 30 ms ab Spindelhochlaufstart bei einer Spindelbeschleunigung von 1.100 U/s<sup>2</sup>

#### **Kompakte Einbaugruppe**

keine zusätzliche Auswerteelektronik im Schaltschrank

#### **Sensoranzahl**

Wahl der Sensoranzahl – Empfehlung min. 4 Sensoren

#### **Geringer Kalibrationsaufwand**

mit nur einem Werkzeug

### SiS from pro micron

#### **Taktzeitneutral**

Messung und Erkennung vor dem Spindelhochlauf

#### **Integration**

Auswerteelektronik außerhalb Spindel

#### **Sensoranzahl**

Jeweils 8 Segmente (Messbrücken) an Plan und im Kegel

#### **Kalibrationsaufwand**

Nicht erforderlich

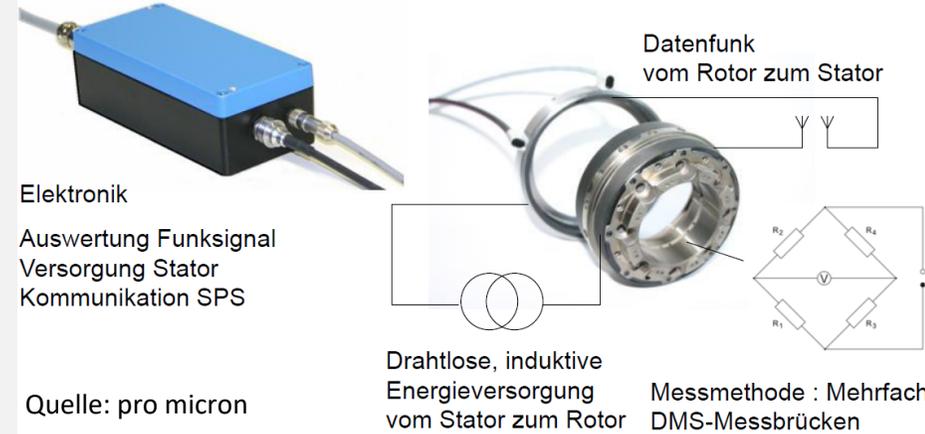
# SIS PRO MICRON / PLANKO OTT JAKOB

## TECHNISCHE DATEN

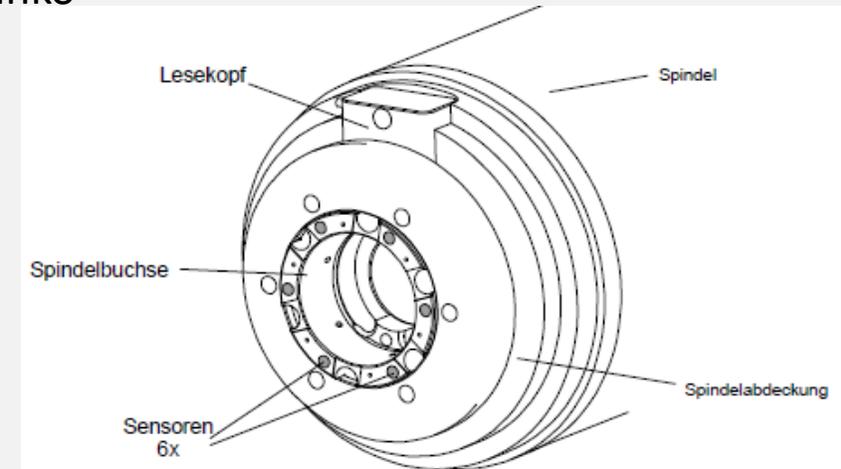
	<b>SiS</b>	<b>Planko</b>
<b>Erkennung von Spänen an:</b>	Plananlage Kegel	Plananlage
<b>Spangröße</b>	>10 µm	>10 µm
<b>Werkzeugschnittstelle</b>	HSK A63 / HSK A80	HSK A63 / HSK A100
<b>Drehzahlfestigkeit</b>	bis 18.000 / 15.000	bis 24.000 / 12.000
<b>Maschinenschnittstelle</b>	Analog 4-20 mA	0-10V
<b>Betriebstemperatur</b>	+10°C bis +60°C	+20°C bis +60°C
<b>Energieversorgung</b>	24V DC (+/- 10%)	24V DC (+/- 10%)

### SiS

← SPS



### Planko



Quelle: Ott Jakob